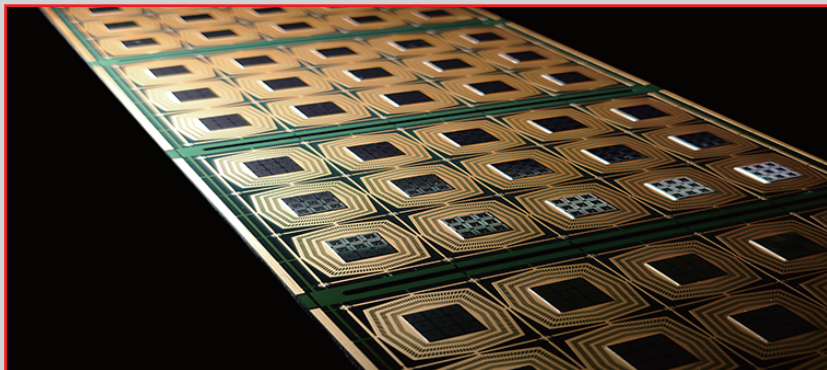


FB-x26

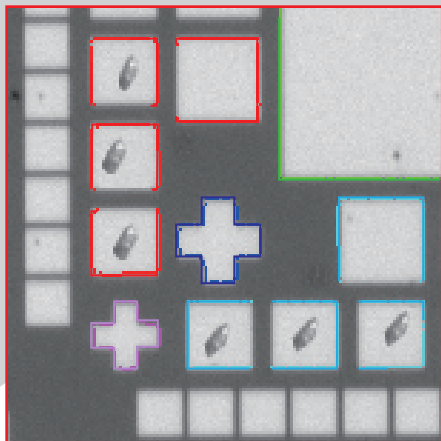
超音波併用熱圧着 (サーモソニック) 方式 高精度ワイヤボンダー
Fully Automatic Thermo-sonic Ball Bonder

KAIJO

幅広デバイスに最適なワイドエリア対応
Bonding area Y=95mm



新認識アルゴリズム α eyes
高速・高精度認識で生産性向上
New recognition algorithm



※オプション装着仕様
※The photograph shows the optional specification

FB-x26 の特長

- Y=95mm ワイドボンディングエリア
Extra large bonding area - Y=95mm
- アップグレードしたトレーサビリティと自己診断機能 品質と設備稼働の管理機能を標準搭載
Enhanced traceability and Self-diagnosis function - Contribute to quality control and maintenance
- 新認識アルゴリズム α eyes を採用 ワーク状態に影響を受けやすい認識精度と認識率を向上
Kaijo's latest optimized recognition - Minimize adverse effects from work condition
- ステップボンドシーケンスを搭載 可視化により直感的なパラメータ操作をサポート
Step Bonding Sequence - Visualized fine process control for enhanced bonding result
- 高まるコネクティビティと Industry4.0 への需要に対応
SECS/GEM 標準搭載 カイジョー独自のホスト管理システム "KISS" も選択可能
Ready for the growing demand of connectivity and industry 4.0 - SECS/GEM or "KISS" (selectable)

FB-x26

■ 主な仕様

ボンディング性能	
ボンディング方式	超音波併用熱圧着（サーモソニック）方式
超音波発振方式	PLL による発振周波数自動追尾、単周波
ボンディング範囲	56mm×95mm*
繰り返し位置精度	$3\sigma \leq 3.0\mu\text{m}$ **
ボンディング速度	50msec / wire(2mm ワイヤ)**
画像認識機能	
認識方式	形状認識方式 (α eyes) と多値化相関処理方式から選択可
検出速度	約 100msec / 2 点 (5mm 角チップ) 約 200msec / 4 点 (5mm 角チップ)
検出率	99% 以上 **
リードロケート検出	最速 11msec / リード
対応ワーク	
パッケージ / フレームサイズ	幅 : 30mm ~ 105mm 長さ : 90mm ~ 300mm 厚さ : 0.1mm ~ 0.5mm
マガジンサイズ	幅 : 30mm ~ 115mm 長さ : 180mm or 200mm 高さ : 100mm ~ 175mm 搭載数 : 2 ~ 3 マガジン
外部通信機能	
	SECS / GEM 搭載 KISS 搭載
ユーティリティ	
電源	単相 AC200V ±5%, 50Hz / 60Hz, 8A ※210V, 220V, 230V, 240V, 100V はオプション 最大消費電力 : 約 1.5kW
エア	圧力 : 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf / cm ²)、ISO クラス5 以上 消費量 : 40Liters / min 以下
真空	圧力 : -53.32MPa 以下 (400mm / Hg 以上)
装置諸元	
寸法	幅 : 1,065mm 奥行 : 1,186mm 高さ : 1,728mm (警告灯上部までは 2,030mm)
重量	重量 : 約 550kg

* セルフティーチ精度を除く。
* * 当社所定の条件下での算出値

■ SPECIFICATIONS

Bonding	
Process	Ultrasonic with thermocompression bonding
Oscillation	Frequency automatic tracking by PLL. Single frequency.
Bonding area	56mm×95mm*
Repeatability of Bonding Accuracy	$3\sigma \leq 3.0\mu\text{m}$ **
Bonding speed	50msec/wire (2mm length Looping)**
Recognition	
Method	Shape recognition (α eyes) or Multi-valued correlation processing (selectable)
Time	Approx. 100msec / 2 points (5mm square chip) Approx. 200msec / 4 points (5mm square chip)
Detection rate	99% or more**
Lead auto-locating (VLL)	11msec / lead
Applicable work size	
Lead frame / Substrate	Width : 30mm ~ 105mm Length : 90mm ~ 300mm Thickness : 0.1mm ~ 0.5mm
Magazine	Width : 30 ~ 115mm Length : 180mm or 200mm Height : 100mm ~ 175mm Stockable : 2 ~ 3 Magazine
External interface	
	SECS / GEM KISS (Kaijo Interconnecting Service System)
Utility	
Power	Single phase AC200V ±5%, 50Hz / 60Hz, 8A (210V, 220V, 230V, 240V ,100V option) Maximum power consumption : Approximately 1.5kW
Dry air	Pressure : 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²) ISO class 5 or more Consumption : 40Liters / min or less
Vacuum	Pressure : -53.32MPa or less (400mm / Hg or more)
Dimensions	
Width Depth Height	1,065mm 1,186mm 1,728mm (To top of signal lamp : 2,030mm)
Weight	Approximately 550kg

* Excluding self-teach accuracy.
** Calculated value under the conditions specified by KAIJO.



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION

東京都羽村市栄町 3-1-5 〒205-8607
3-1-5, Sakae, Hamura, Tokyo, JAPAN 205-8607

URL <https://www.kaijo.co.jp>

ボンダー事業部

TEL. 042-555-6162

FAX. 042-579-5175

✉ bonder-info@kaijo.co.jp

● 国内営業（東日本）/ Sales Department (Tokyo)

● 国内営業（西日本）/ Sales Department (Osaka)

● 海外営業 / Overseas Sales

● カスタマーサポート・ヘルプデスク / Customer Support Help-desk

● 台湾海上希歩洋股份有限公司 / TAIWAN KAIJO SHIBUYA CORPORATION

● 上海楷捷半導體科技有限公司 / KAIJO SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO.,LTD.

● KAIJO SHIBUYA EUROPE GmbH (GERMANY)

● シンヤカイジョー（タイランド）/ SHIBUYA KAIJO(THAILAND) CO.,LTD.

● シンヤカイジョー（マレーシア）/ SHIBUYA KAIJO(MALAYSIA) SDN. BHD.

TEL.042-555-8889

TEL.06-4805-0231

TEL.042-555-0321 / +81-42-555-0321

TEL.042-555-4834 / +81-42-555-4834

TEL.+886-2-8712-2377

TEL.+86-21-6275-1515

TEL.+49-611-72429155

TEL.+66(0)2673-9496-8

TEL.+60(0)4-611-6040 (PENANG Office)

ご用命は